股票简称:气派科技 股票代码:688216

气派科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

CHINA CHIPPACKING TECHNOLOGY CO.,LTD.

(深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1# 厂房 301-2)

保荐机构(主承销商) 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.

(贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号)

二〇二一年六月二十二日

特别提示

气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”、“公司”或“发行人”)股票将于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,首日跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后的前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,高管及核心员工专项资管计划战略配售股份锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 21,631,528 股,占发行后总股本的 20.36%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为 14.82 元 / 股,此价格对应的市盈率为:

1、15.84 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、14.70 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、21.11 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、19.60 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至 2021 年 6 月 7 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 41.59 倍。本次发行价格对应的公司 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.11 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,特别关注以下重大风险提示,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。

(一)以传统封装产品为主,先进封装市场竞争力较弱的风险

根据 Yole 相关预测,从 2019 年至 2025 年,全球半导体封装市场的营收将以 4%的年复合增长率增长,其中先进封装市场将以 6.6%的年复合增长率增长,传统封装市场将以 1.9%的年复合增长率增长。根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体产业发展状况报告(2020 年版)》,到 2019 年底,国内封装测试企业仍以传统封装为主,先进封装的销售占比仅为 35%。

报告期内,公司主要收入来源于 SOP、SOT 等传统封装形式产品,公司 SOP、SOT 等传统封装形式产品实现的主营业务收入分别为 33,169.46 万元、35,991.83 万元、42,739.27 万元,占当期主营业收入的比例分别为 93.11%、91.42%、80.74%。

相较行业内领先企业,公司在先进封装技术方面的研发人才储备及研发投入不足,因而公司在 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装领域的产品设计、工艺积累、研发能力等与日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业存在较大的技术差距。该等技术差距导致公司产品线丰富程度、产品应用领域、市场占有率、高端封装产品等方面处于追赶地位,公司在先进封装产品市场的竞争力相对较弱。如果未来公司不能通过内部培养和引进外部高素质的先进封装技术研发人才、加大对先进封装技术的研发投入缩小与国内外领先企业的技术差距,无法开发出满足市场需求的 3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装形式产品,将导致公司核心竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(二)集成电路封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来,集成电路终端系统产品的多任务、小体积的发展趋势带动了集成电路封装技术朝着高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展,相应的 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装技术应用领域越来越广泛。日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面的掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装技术,而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主,相应的公司产品面临技术升级迭代风险。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代,将可能使得公司市场空间变小;或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断,快速识别并响应客户需求的变化,在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入,或者正在研发的新产品不能满足客户需要,将难以开拓新的业务市场;进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)市场竞争加剧风险

一方面,长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金增加生产线、进行技术和产品的升级改造以提升产品产能、质量和技术水平,还通过收购兼并的方式实现了产能的大幅提升和技术的升级迭代。另一方面,外资和合资封装测试企业进一步布局中国大陆,加大了资金和资源的投入。因此,公司作为国内集成电路封装测试第二梯队企业,相关产品不仅面临国内、国际同行业企业的激烈竞争,还面临行业潜在或新进入者的竞争威胁。如未来集成电路封装测试行业市场竞争进一步加剧,将可能导致公司产品市场竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外,公司目前产品结构以传统封装为主。传统封装虽然市场规模大且保持持续增长,但相比先进封装,传统封装增速趋缓;同时,主流传统封装技术成熟、传统封装产品以标准化产品为主,存在同质化竞争的情形,因而传统封装市场竞争更为激烈。若公司不能持续保持传统封装产品的市场竞争力,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(四)公司自主定义封装形式无法得到市场广泛认可而导致市场空间受限的风险

报告期内,公司自主定义的 Qipai、CPC 系列产品实现的营业收入分别为 2,511.20 万元、2,353.17 万元、1,903.39 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 7.05%、5.98%、3.60%;公司自主定义的 CQFN/CDFN 产品已进入小批量生产阶段。

公司自主定义的 Qipai、CPC、CQFN/CDFN 封装形式产品为非标产品,存在与其它封装形式的兼容性问题,客户和终端用户会担心供货能力和供应商的可选择性;此外,使用新封装形式需要重新设计、认证线路板,对性能复杂的终端产品需要进行各种性能、安全、可靠性等认证并得到用户的认可,相应的 Qipai、CPC、CQFN/CDFN 封装形式产品对已有产品的替代程序较多、周期较长。受前述原因影响,公司自主定义的 Qipai、CPC、CQFN/CDFN 封装形式产品存在不能得到市场广泛认可而导致市场增长或空间受限的风险。

(五)先进制程芯片封装能力较弱及 12 吋晶圆尺寸封装产品很少的风险

公司报告期内封装测试产品芯片制程以 90 纳米以上为主,占比超过 95%,90 纳米以下制程占比很低。随着芯片制程技术的快速发展,先进节点已走向 10 纳米、7 纳米、5 纳米。芯片制程越先进,其所生产的芯片集成度越高、芯片输出端口越多、封装脚位越多,相应的封装可靠性风险越高,对封装技术水平的要求相应提高。目前公司封装产品制程以 90 纳米以上为主,先进制程芯片封装能力较弱,与日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业存在较大的技术差距。

报告期内,公司封装测试产品所用晶圆以 6 吋、8 吋为主,占比超过 90%,12 吋占比极低。单片 12 吋晶圆能生产更多芯片,已经成为全球先进晶圆加工工艺的主流,但由于尺寸更大,使得其设备投入更高,加工工艺及品质管控更具挑战性。公司目前封装形式产品所用晶圆主要为 8 吋以下,12 吋晶圆占比与国内外领先企业存在一定的差距。

若未来公司不能通过持续的研发投入及技术升级缩小与国内外领先企业在先进制程芯片封装技术、12 吋晶圆尺寸产品上的差距,将导致公司核心竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(六)销售区域集中风险

报告期内,公司业务主要集中在华南地区,2018 年至 2020 年,公司来自于华南地区的主营业务收入占比分别为 62.59%、59.51%和 54.53%,如果华南地区的销售情况出现重大不利变化,将对公司业务发展产生不利影响。

(七)业绩及毛利率波动风险

公司主要从事集成电路封装测试业务,经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化;同时,集成电路封装测试行业竞争激烈,价格相对透明,相应的封装测试企业整体毛利率水平不高,2018 年至 2020 年,公司主营业务毛利率分别为 18.93%、20.75%和 28.33%。

未来若终端产品市场出现较大波动,或者随着市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格,公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险,从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

(八)实际控制人不当控制风险

本次发行前,梁大钟、白瑛夫妇合计直接持有公司 77.73%的股份,梁大钟通过气派谋远间接控制公司 0.02%的股份;同时梁大钟担任公司董事长、总经理,白瑛担任公司董事;梁大钟、白瑛夫妇为公司的实际控制人。本次发行完成后,梁大钟、白瑛仍将持有本公司 58.29%的股份,梁大钟通过气派谋远间接控制公司 0.01%的股份(假设公司公开发行新股 2,657 万股,且未进行老股转让),梁大钟、白瑛仍将为公司实际控制人。未来梁大钟、白瑛若不能很好的约束自身行为,通过在股东大会上行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等重大事项予以不当控制,将可能对公司发展产生不利影响、损害公司及其他股东的利益。

(九)进口设备依赖的风险

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司现有机器设备中无国产替代的进口设备原值为 24,072.71 万元、已有国产替代的进口设备原值为 24,986.53 万元,该等进口设备广泛应用于健合、装片、减薄划片、切筋成型、测试等生产工序,对公司生产经营十分重要。同时,公司本次募集资金投资项目将向日本东京精密株式会社、ASM、日本东和株式会社等境外知名集成电路设备生产商采购设备 31,564.18 万元(含税),其中暂无国产替代的进口设备 26,555.62 万元(含税)、已有国产替代的进口设备 5,008.56 万元(含税)。

截至目前,公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧,美国进一步加大对半导体生产设备及其生产技术的出口管制力度和范围,如本公司现有进口设备出现使用受限的情形,则本公司生产经营将受到较大不利影响;如募集资金投资项目所需进口设备被限制出口或受管制,则将对本公司募集资金投资项目的顺利实施带来不利影响,从而影响公司发展战略及发展目标的实现,将对公司未来发展和经营业绩造成较大不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1714 号”文同意注册,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》(〔2021〕260 号)批准,公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,公司 A 股股本为 10,627.00 万股(每股面值 1.00 元),其中 21,631,528 股股票将于 2021 年 6 月 23 日起上市交易。证券简称为“气派科技”,证券代码为“688216”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021 年 6 月 23 日

(三)股票简称:气派科技;扩位简称:气派科技

(四)股票代码:688216

(五)本次公开发行后总股本:10,627.00 万股

(六)本次公开发行股票数量:2,657.00 万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:21,631,528 股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:84,638,472 股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:

保荐机构另类投资子公司兴贵投资有限公司获配数量为 132.85 万股,公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“气派员工资管计划”)获配数量为 265.70 万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

兴贵投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

气派员工资管计划本次获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 479 个,这部分账户对应的股份数量为 952,972 股,占网下发行总量的 7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.22%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:华创证券有限责任公司

三、本次发行选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”中规定的市值及财务指标。

本次发行价格为 14.82 元 / 股,发行后公司总股本为 10,627.00 万股,上市时公司市值为 15.75 亿元,不低于人民币 10 亿元。公司 2019 年、2020 年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 2,946.00 万元、7,458.78 万元,2020 年营业收入为 54,800.45 万元。公司满足《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》之 2.1.2(一)的“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	气派科技股份有限公司
英文名称	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
注册资本	7,970.00 万元
法定代表人	梁大钟
有限公司成立日期	2006年 11 月 7 日
股份公司成立日期	2013年 6 月 6 日
住所	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1# 厂房 301-2
主要生产经营地址	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
经营范围	一般经营项目是:集成电路的研发、测试封装、设计、销售(不含蚀刻等有工业废水产生的工艺及其他限制项目),货物进出口、技术进出口;设备租赁(不含融资租赁)(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:
主营业务	集成电路的封装、测试
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
邮政编码	523330
联系电话	0769-89886666
传真	0769-89886013
电子邮箱	wenzg@chippacking.com
公司网址	http://www.chippacking.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	证券法律事务部
信息披露负责人	文正国
信息披露负责人电话	0769-89886666-8501
信息披露人电子邮箱	wenzg@chippacking.com

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东基本情况

公司控股股东为梁大钟。本次发行前,梁大钟直接持有公司 51,150,000 股股份,通过气派谋远间接控制公司 15,000 股股份,合计控制公司 51,165,000 股股份,占公司股份总数的 64.20%,系公司的控股股东。

(二)实际控制人基本情况

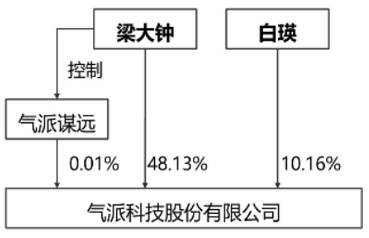
公司实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇。本次发行前,梁大钟、白瑛合计直接持有公司 61,950,000 股股份,占公司股份总数的 77.73%;同时梁大钟通过气派谋远间接控制公司 15,000 股股份,占公司股份总数的 0.02%;梁大钟担任公司董事长、总经理职务,白瑛担任公司董事职务,梁大钟和白瑛夫妇为公司实际控制人。

梁大钟,男,出生于 1959 年 2 月,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:33060219590205****,住所:深圳市福田区。梁大钟为公司董事长、总经理,本科,毕业于电子科技大学固体器件专业;1984 年 8 月至 1990 年 3 月任华越微电子有限公司工程师;1990 年 3 月至 1997 年 11 月在深圳市电子市场从事业务工作;1997 年 11 月至 2008 年 11 月任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理;2001 年 4 月至 2012 年 12 月任天光集成执行董事、总经理;2006 年 11 月至 2013 年 6 月任气派有限执行董事、总经理;2013 年 6 月至今任公司董事长、总经理;2013 年 5 月至今任广东气派执行董事、总经理。

白瑛,女,出生于 1964 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:33060219640529****,住所:深圳市福田区。白瑛为公司董事,高中;1983 年 9 月至 1992 年 5 月就职于华越微电子有限公司;1992 年 6 月至 1997 年 11 月在深圳电子市场从事业务工作;1997 年 11 月至 2008 年 11 月任深圳市天光微电子有限公司副总经理,2001 年 4 月至 2012 年 12 月任天光集成监事;2006 年 11 月至 2013 年 6 月任气派有限监事;2013 年 6 月至今任公司董事。

(三)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,具体情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	梁大钟	董事长	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
2	白瑛	董事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
3	施保球	董事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
4	孟宇	董事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
5	周生明	独立董事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
6	左志刚	独立董事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
7	王春青	独立董事	2020年 8 月 12 日至 2022 年 7 月 18 日

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,具体情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	邓大悦	监事会主席	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
2	赵红	监事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
3	孙少林	职工代表监事	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员共 7 名,公司高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	梁大钟	总经理	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
2	施保球	副总经理	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
3	饶锡林	副总经理	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
4	陈勇	副总经理	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
5	胡明强	副总经理	2019年 11 月 14 日至 2022 年 7 月 18 日
6	文正国	副总经理、董事会秘书	2019年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
7	李泽伟	财务总监	2020年 3 月 2 日至 2022 年 7 月 18 日

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共 7 名,核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职位
1	梁大钟	董事长、总经理
2	施保球	董事、副总经理、总工程师
3	饶锡林	副总经理、研发中心副主任
4	易炳川	研发主管
5	黄乙为	研发中级工程师
6	张怡	研发中级工程师
7	程浪	研发中级工程师

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况如下(不含公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

姓名	关联关系	直接持股数(股)	间接持股		合计持股		限售期限
			股东名称	间接持股数(股)	数量(股)	占比(%)	
梁大钟	董事长、总经理	51,150,000	气派谋远	5,000	51,155,000	48.14%	36个月
白瑛	董事	10,800,000	-	-	10,800,000	10.16%	36个月
施保球	董事、副总经理、总工程师	2,000,000	-	-	2,000,000	1.88%	12个月
邓大悦	监事会主席	-	昆石天利	27,785.75	27,785.75	0.03%	12个月
		-	昆石创富	142.86	142.86	0.0001%	12个月
赵红	监事	90,000	-	-	90,000	0.08%	12个月
饶锡林	副总经理	280,000	-	-	280,000	0.26%	12个月
陈勇	副总经理	250,000	-	-	250,000	0.24%	12个月
胡明强	副总经理	300,000	-	-	300,000	0.28%	12个月
文正国	副总经理、董事会秘书	310,000	-	-	310,000	0.29%	12个月
李泽伟	财务总监	295,000	-	-	295,000	0.28%	36个月
梁瑶飞	梁大钟之妹	50,000	-	-	50,000	0.05%	36个月

公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售持有公司股票的情况,详见本节“七、战略配售”。

上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

(六)董事、监事、高级管理人员持有公司债券情况

截至本上市公告书签署之日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况

本次公开发行前,公司未制定或实施股权激励计划、员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为 7,970.00 万股,本次公开发行新股 2,657.00 万股,发行后公司总股本为 10,627.00 万股。本次发行前后公司的股本结构变动情况如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例	
一、有限售条件流通股					
梁大钟	51,150,000	64.18%	51,150,000	48.13%	自上市之日起锁定 36 个月
白瑛	10,800,000	13.55%	10,800,000	10.16%	自上市之日起锁定 36 个月
童晓红	2,650,000	3.32%	2,650,000	2.49%	自上市之日起锁定 12 个月
深创投	2,300,000	2.89%	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定 12 个月
昆石天利	2,300,000	2.89%	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定 12 个月
施保球	2,000,000	2.51%	2,000,000	1.88%	自上市之日起锁定 12 个月
杨国忠	1,500,000	1.88%	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定 12 个月
昆石创富	1,500,000	1.88%	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定 12 个月
东莞红土	1,300,000	1.63%	1,300,000	1.22%	自上市之日起锁定 12 个月
深圳红土	1,000,000	1.25%	1,000,000	0.94%	自上市之日起锁定 12 个月
文正国	310,000	0.39%	310,000	0.29%	自上市之日起锁定 12 个月
胡明强	300,000	0.38%	300,000	0.28%	自上市之日起锁定 12 个月
李泽伟	295,000	0.37%	295,000	0.28%	自上市之日起锁定 36 个月
饶锡林	280,000	0.35%	280,000	0.26%	自上市之日起锁定 12 个月
陈勇	250,000	0.31%	250,000	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
林治广	240,000	0.30%	240,000	0.23%	自上市之日起锁定 12 个月
刘明才	200,000	0.25%	200,000	0.19%	自上市之日起锁定 12 个月
梁晓英	160,000	0.20%	160,000	0.15%	自上市之日起锁定 36 个月
高宏德	120,000	0.15%	120,000	0.11%	自上市之日起锁定 12 个月
李庆丹	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定 12 个月
冯学贵	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定 12 个月
李奎	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定 12 个月
赵红	90,000	0.11%	90,000	0.08%	自上市之日起锁定 12 个月
雷刚	80,000	0.10%	80,000	0.08%	自上市之日起锁定 12 个月
刘方标	80,000	0.10%	80,000	0.08%	自上市之日起锁定 12 个月
徐胜	60,000	0.08%	60,000	0.06%	自上市之日起锁定 12 个月
梁瑶飞	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定 36 个月
斯毅平	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
陈回多	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
祝小健	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
徐东海	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
蔡佳贤	40,000	0.05%	40,000	0.04%	自上市之日起锁定 12 个月
刘欣	40,000	0.05%	40,000	0.04%	自上市之日起锁定 12 个月
郑涛	30,000	0.04%	30,000	0.03%	自上市之日起锁定 12 个月
徐亮	30,000	0.04%	30,000	0.03%	自上市之日起锁定 12 个月
江明明	30,000	0.04%	30,000	0.03%	自上市之日起锁定 12 个月
气派谋远	15,000	0.02%	15,000	0.01%	自上市之日起锁定 36 个月
气派员工资管计划	-	-	2,657,000	2.50%	自上市之日起锁定 12 个月
兴贵投资有限公司	-	-	1,328,500	1.25%	自上市之日起锁定 24 个月
网下限售股份	-	-	952,972	0.90%	自上市之日起锁定 6 个月
小计	79,700,000	100.00%	84,638,472	79.64%	-
二、无限售条件流通股					
无限售条件流通股	-	-	21,631,528	20.36%	-
合计	79,700,000	100.00%	106,270,000	100.00%	-

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	梁大钟	51,150,000	48.13%	自上市之日起锁定 36 个月
2	白瑛	10,800,000	10.16%	自上市之日起锁定 36 个月
3	华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,657,000	2.50%	自上市之日起锁定 12 个月
4	童晓红	2,650,000	2.49%	自上市之日起锁定 12 个月
5	深圳市创新投资集团有限公司	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定 12 个月
6	北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定 12 个月
7	施保球	2,000,000	1.88%	自上市之日起锁定 12 个月
8	杨国忠	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定 12 个月
9	深圳市昆石投资有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定 12 个月
10	兴贵投资有限公司	1,328,500	1.25%	自上市之日起锁定 24 个月
合计		78,185,500	73.57%	-

七、战略配售

本次发行涉及的战略投资者包括保荐机构相关子公司兴贵投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的气派员工资管计划。

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公司兴贵投资有限公司参与本次发行的战略配售,兴贵投资有限公司本次跟投获配股票数量为 132.85 万股,占本次发行数量的 5%,获配金额为 19,688,370.00 元,获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

发行人高级管理人员、核心员工通过气派员工资管计划参与本次发行的战略配售,获配股票数量为 265.70 万股,占本次发行数量的 10%,最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 39,573,623.70 元(其中获配股数对应的金额 39,376,740.00 元,相应的新股配售经纪佣金 196,883.70 元),获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

1、基本情况

具体名称:华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021 年 3 月 12 日

募集资金规模:7,173.90 万元

管理人:华创证券有限责任公司

实际支配主体:华创证券有限责任公司

2、参与人姓名、职务、参与金额及比例

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	比例
1	梁大钟	董事长、总经理	2,436.90	33.97%
2	饶锡林	副总经理	918.00	12.80%
3	文正国	副总经理、董事会秘书	864.00	12.04%
4	陈勇	副总经理	864.00	12.04%
5	李泽伟	财务总监	729.00	10.16%
6	冯学贵	技术副总监、研发中心主任	405.00	5.64%
7	雷刚	人力资源副总监	351.00	4.90%
8	斯毅平	生产副总监	486.00	6.78%
9	CHEN SIN FU	品质总监	120.00	1.67%
合计			7,173.90	100.00%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2,657.00 万股,全部为公开发行新股。

二、每股价格

本次发行价格为 14.82 元 / 股。

**三